超低熱膨張新 â£

採用実績も ステッパー向け定盤に

平均熱壓張係殼、×10-6/C

3

2.5

2

1.5

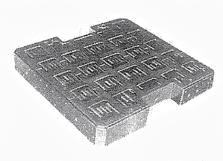
0.5

0

-200

- 150

-0.5- 1



《李囲気曝露前:1.1×10

似零期与践器後:0.7×10

張を維持しながら高剛性 囲気に20日間保持しても TAR」ならびに低熱膨 を実現した「LEX―S |熟膨張係数1 p p m | (ヤング率は152GP マイナス269℃の雰 市場投入した。

な 具などへの採用を見込 をはじめ、超精密検査治 ップに加えた。ステッパ a)を実現した「LEX -18E」を製品ラインア (縮小投影型露光装置

6) は、半導体製造装置 44-322-375 崎区白石町2-1、20

日本鋳造㈱

(川崎市川

などの精密加工装置ので

合金材料 | LEX-ZE 係数がほぼゼロという新 に、3年ほど前に熱膨張 た鋳物製造技術をベース 同社は、長年培ってき

医療機器、光学検査装置 液晶製造装置をはじめ を上市。これまで半導体 RO(レックス・ゼロ) 工作機械、精密測定装置

レベルの超大型品まで対 いる。『単位から十数1 鋳造品などに採用されて 装置の台座のほかボル 向けなど、数百件にのぼ ト、精密な治具など精密 る案件を受注した。大型

として新たに2製品を開

超低熱膨張の新合金材料 ナージに採用実績を持つ

100

も関連特許を申請済み り、同時に海外主要国で 国内特許も取得してお で、特許が成立した国も 発・商品化した。 高度な低熱膨張合金を開 分の微調整を行うことで すでにこれらに関する

る予定だ。 材料について、4月5日 最新の開発製品を紹介す 水 連の低熱膨張の新合金 第4回高機能金属展 東京ビッグサイト)で なお、同社が開発した から開催される

あるという。

でも熱膨張係数 1

-100

-50

20℃からの温度範囲

金の鋳造品を提供して含 たが、鋳造プロセスは下 などの空隙が生じやすい 同社はこれまで開発合 製品内部にボイド

応可能だ。 ブロック材としては最

処理も請け負う。 までの範囲であれば需要 0 m~最小0×0×10×10 大400×400×15 金型などへの加工・表面 た、必要であれば定盤さ に合わせて提供可能。 同社は30年以上にわた

り低熱膨張合金の開発 発し、安定した状態で成 鋼を特殊処理できる精錬 鉄。ニッケル・コバルト 製造に取り組んできた。 分を正確に制御して、 合金などからなる化学成 ・真空脱ガス炉を自社脚

50

-8/°C (-199~90°C)

指す。 期的には20億円規模を目

引き続き積極的な事業拡 の採用も始まっており、 車組立などの製造装置 製品の半数以上を占める 品が増加しており、 造プロセスを採用した製 う。ここ2年で、この鍛 品提供も確立したとい した鍛造プロセスでの製 最近の顧客需要に応じ ため、鋳造プロセスでも り、競合他社製品よりも ガス手法を確立してお ようになった。 高精度な超合金材料に仕 上げることが可能だが、 ボイド発生が低い。この 上高は数億円だが、中長 入を図る。現在、年間売 ことから、独自の真空脱 て、さらにボイドを除去 すでに食品加工や自動